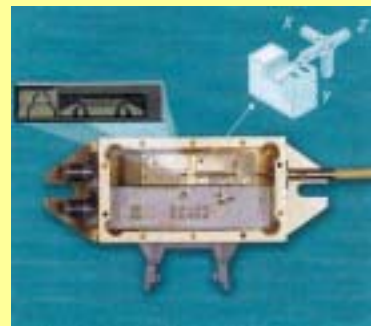


ITG-Workshop

Photonische Aufbau- und Verbindungstechnik



15./16. Mai 2003



Hochschule Harz, Wernigerode
Friedrichstr. 57, 38855 Wernigerode, Germany

VDE

**Tagungsprogramm Workshop
„Photonische Aufbau- und Verbindungstechnik“
Wernigerode**

Donnerstag, 15. Mai 2003

13:30 Uhr Begrüßung Rektorin Fr. Prof. Assenmacher /
Prof. Fischer-Hirchert

Session 1: "Packaging"

Chairman: U. Fischer-Hirchert

- 13:45 Die 5. Leiterplattengeneration – EOCB (invited)
W. Scheel, Fraunhofer IZM Berlin
- 14:15 Elektro-Optische Leiterplatten mit konventioneller Technik fertigen?!
K. Schmieder, KSG Leiterplatten GmbH, Gornsdorf
- 14:40 Neues Low-Cost Modul Package für bidirektional Datenübertragung
V. Plickert, L. Melchior, Infineon Technologies, Berlin
- 15:05 Low Cost Packages für 1300nm VCSEL - vom TO zum SMD.
M. Weigert, Infineon Technologies AG, Berlin
- 15:30 The Road to Recovery of the Optoelectronic Component Industry
*M. A. Tolbert, S. Ragona,
EXFO Burleigh Products Group, Victor (USA)*
- 15:55 Kaffeepause (Foyer)**

Session 2: " Mikrooptische Komponenten und Systeme"

Chairman: **U. Wallrabe**

- 16:30 „Mikrooptische Elemente für die hochbitratige Datenübertragung“ (invited)
K. Schulz, Merge Optics , Berlin
- 17:00 Optisches Element für 1x2 Einmoden-Faserschalter aus anisotrop
geätztem Silicium
D. Nüsse, M. Hoffmann, E. Voges
Universität Dortmund, Lehrstuhl für Hochfrequenztechnik, Dortmund
- 17:25 Automatisierte Justage und Montage von mikrooptischen Singlemode-
Faserschaltern
F. Wippermann, K. Kubitz, T. Harzendorf, R. Göring
pyramid optics GmbH , Lederhose
- 17:50 Aufbau und Verbindungstechnik für mikrooptische Abstandssensoren
(Modulares Fertigungskonzept)
U. Hollenbach, U. Wallrabe, J. Mohr, T. Oka
FZ Karlsruhe GmbH, Institut für Mikrostrukturtechnik, Karlsruhe

18:15 - 19:30 “come together“ im Foyer mit kleinem Imbiss und Hasseröder Bier

Freitag, 16. Mai 2003

Session 3: "Optische Verbindungstechniken"

Chairman: G. Walf

- 9:00 Technologien für optische Steckerschnittstellen (BMBF-Projekt OPST II)
A. Ambrosy¹, M. Beck², I. Frese³, K. Rueß¹, S. Schmid⁴t, J. Ziegler⁴
¹Alcatel SEL AG, ²OSI GmbH, ³IMM Mainz, ⁴Rosenberger GmbH
- 9:30 Multifaserkopplung für schräg zur Kristallkante liegende Wellenleiter
Th. Rosin, H. Ehlers, M. Schlak
Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik Heinrich-Hertz-Institut (HHI)
Berlin
- 9:55 Waveguide-fed photo diodes with optical spot size expanders integrated
in modules with optimized fiber-chip coupling
U. H. P. Fischer-Hirchert³, J. Honecker¹, A. Umbach¹, D. Trommer¹, Th.
Eckhardt², ¹U2T Photonics AG, ²HHI Berlin, ³HS-Harz Wernigerode
- 10:20 Sondertechnologien der Faseroptik - Faserlinsen und Laserschweißen
H. Schröder, G. Lang, N. Arndt-Staufenbiel, J. Krissler, W. Scheel
Fraunhofer IZM Berlin
- 10:45 Zukunft der Steckverbinder, Steckverbinder der Zukunft
W. Coenning, Diamond GmbH, L.-Echterdingen
- 11:10 Kaffeepause (Foyer)**

Session 4: "Lötprozesse"

Chairman: A. Ambrosy

- 11:45 Laserlöten mikrooptischer Komponenten
*R. Eberhardt, H. Banse, W. Stöckl,
Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik (IOF), Jena*
- 12:10 Betrachtung von galvanisch erzeugten AuSn Bumps unter
geometrischen Gesichtspunkten und die Auswirkungen auf den
Bumpingprozess und Flip-Chip-Montage
M. Hutter, Fraunhofer IZM, Berlin,
- 12:35 A Fluxfree Soldering Process for Local Hermetic Sealing of
Optoelectronic Subassemblies
*G. Elger, L. Shiv, C. Ching-Hua, A. Kilian, A. Hase, M. Heschel,
J. Kuhmann, Hymite GmbH, Berlin, Lyngby (DK)*
- 13:00 **Abschlussworte und Ende des Workshops**